

ÜBERSICHT 2024

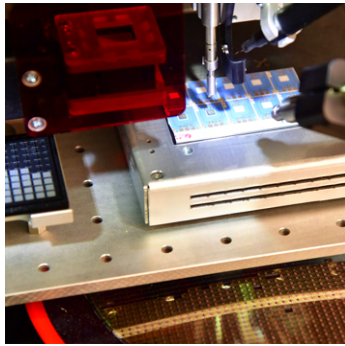
TRESKY Lösungen für die Mikroelektronik



von manuell
zu halbautomatisch

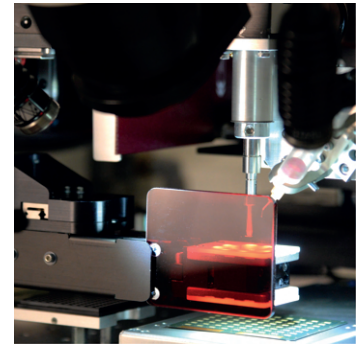


MIKROFERTIGUNG



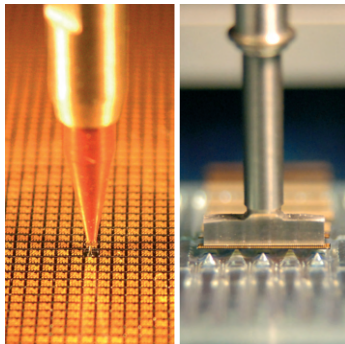
Die Bestückung

Sub-Mikron-Bonden
Vollständige Prozesskontrolle
Kontrolle der Bondkraft
True Vertical Technology™
Intuitiv und einfach in der Anwendung

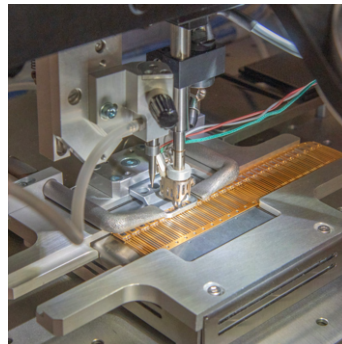


Flip-Chip & 3D Verpackung

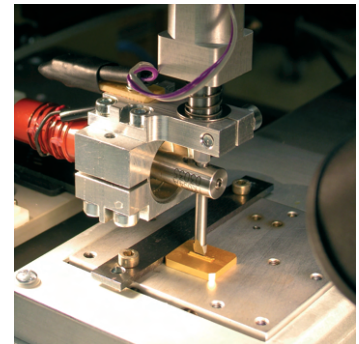
TRESKY ÜBERSICHT



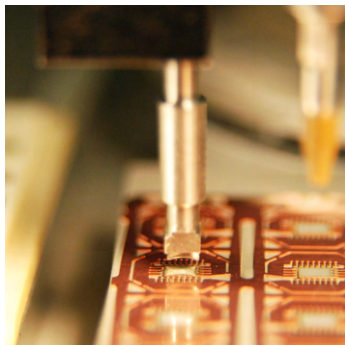
Die Sortierung



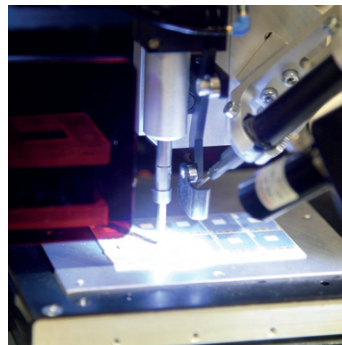
Eutektisches Kleben



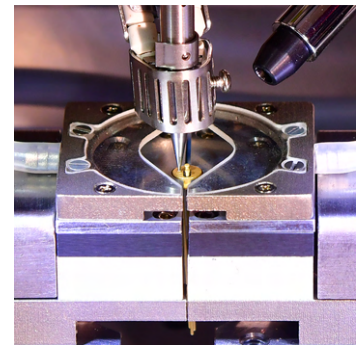
Ultraschall & Thermo-sonic



Dosieren & Stempeln



UV Härtung



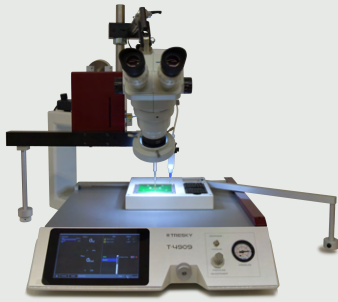
TO eutektisches Kleben



TRESKY

Dr. TRESKY AG
Schweiz
tresky@tresky.com
www.tresky.com

T-4909-AE



Kostengünstiges Die-Bonden-System

- Manuelle Z-Achse mit digitaler Anzeige der Bondkraft
- Integrierter Dispenser

Applikationen:

Flip-Chip Bonding, Eutektik, Die Bestückung, ...

T-5100 & T-5100-W



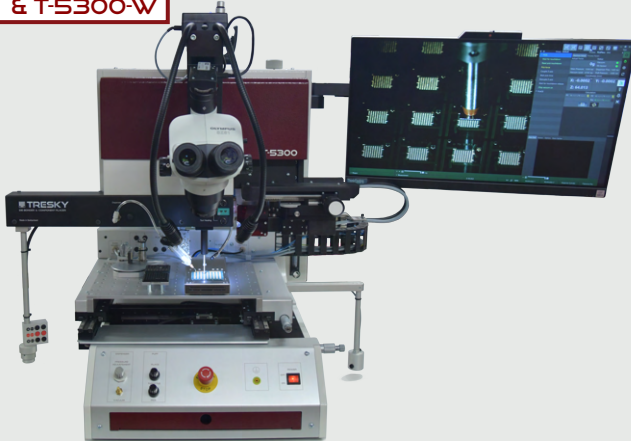
Präzises Multi-Anwendungssystem

- Manuelle Z-Achse mit digitaler Anzeige der Bondkraft
- Integrierter Dispenser
- Einfaches und sicheres Aufnehmen von Wafern auf dem T-5100-W

Applikationen:

Sub-Mikron-Bonden, Flip-Chip, Die Bestückung, Eutektik, Eutektisches TO Bonden, Thermosonic, ...

T-5300 & T-5300-W



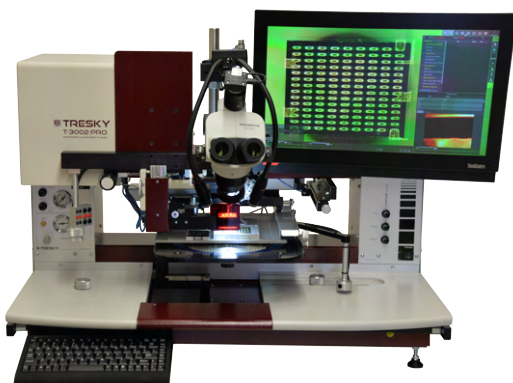
Präzises Multi-Anwendungssystem

- Motorisierte Z-Achse, aktive Kraftkontrolle
- PC-Steuerung für alle Bonding-, Temperatur- und Visionparameter
- Einfaches und sicheres Aufnehmen von Waffel/ Gel-Packs, ...
- Integrierter Dispenser
- Einfaches und sicheres Aufnehmen von Wafern auf dem T-5300-W

Applikationen:

Sub-Mikron Bonden, Flip-Chip, Pre-Sinter Bonding, Eutektische Die Bestückung, Eutektisches TO Bonden, Thermosonic & Thermokompression, Stapeln, Klebstoffe mit Bond-liniendicke, UV Härtung, ...

T-3000-PRO-HF & T-3002-PRO-HF



High Force Multi-Anwendungssystem

- Motorisierte Z-Achse, Kraftkontrolle (bis zu 500N)
- PC-Steuerung für alle Bonding-Parameter und Bildgebung
- Integrierter Dispenser
- Einfaches und sicheres Aufnehmen vom Wafer, auf dem T-3002-PRO-HF

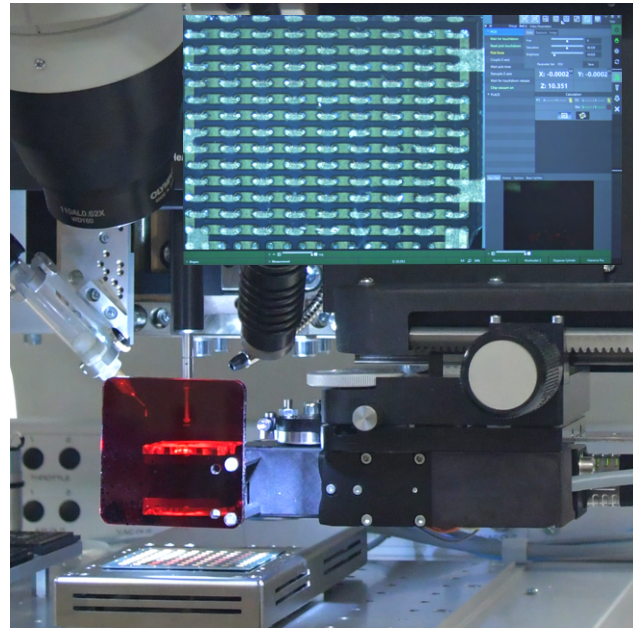
Applikationen:

Flip-Chip, Pre-Sinter Bonding, Eutektische Die Bestückung, Eutektisches TO Bonden, Thermosonic & Thermokompression, Stapeln, Klebstoffe mit Bond-liniendicke, UV Härtung, ...

FLIP-CHIP

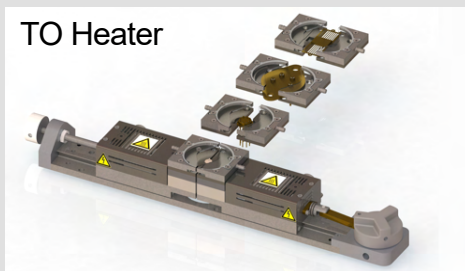
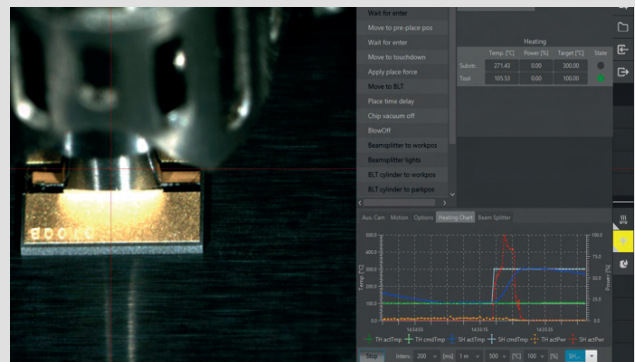
Hochauflösende Platzierungseinheit mit Beam-Splitter für ultrapräzise Mehrpunkt-Ausrichtung mit submikroner Auflösung. Zusätzliche Ausrichtungsfunktionen wie Kantenerkennung für die obere Chip-Ausrichtung.

- Hochpräziser Beam-Splinter mit 1x oder 2x hochauflösender Optik
- 400-facher digitaler Zoom Ultra-HD-Kamera
- Mehrpunkt-Ausrichtung (mit verschiedenen Reichweiten) für hohe Genauigkeit
- Optische Auflösung von 1,25 µm oder 0,625 µm
- Sichtfeld 1,2x0,9 mm – 6,5x4,9 mm oder 0,6x0,5 mm – 3,3x2,5 mm
- LED-Beleuchtung (oben, unten und koaxial)



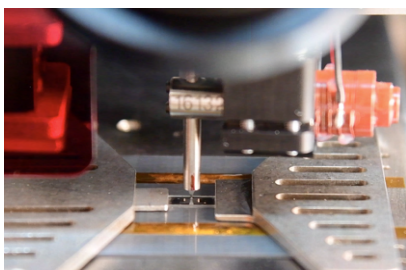
FLIP-CHIP 2X AUTO.

XYZ-motorisierte / programmierbare Version der Standard-Flip-Chip-Option. Sie erhöht die Benutzerfreundlichkeit und ist für die präzise Ausrichtung auf verschiedenen Höhen (z. B. Stapeln) ausgelegt. Darüber hinaus ist sie mit RGBW-LED-Beleuchtung ausgestattet.

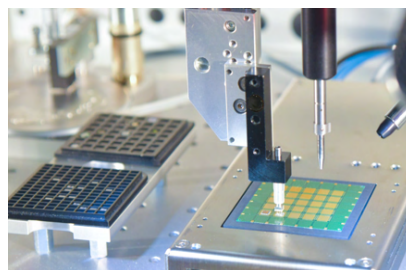


TO Heater

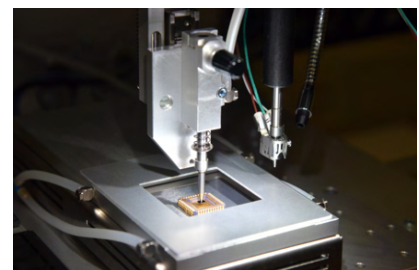
- Heizplatten für statische Temperaturen oder für das Aufheizen/Abkühlen (bis zu 450°C)
- Fluten mit kaltem oder beheiztem Formgas
- Werkzeugheizung für statische Temperaturen oder für das Aufheizen/Abkühlen (bis zu 450°C)
- Software zur Verwaltung verschiedener Temperaturprofile



Scrubbing Bewegung oder
Ultraschall-Bonding-Aktion



Stamping für die Anwendung
von Klebstoff



2nd spindel für Preform
pick-up

T-VERGLEICHE



| | T-4909-AE | T-5100 | T-5100-W | T-5300 | T-5300-W | T-3000-PRO-HF | T-3002-PRO-HF |
|---|-----------|--------|----------|--------|----------|---------------|---------------|
| XY-Bewegung 180mm x 180mm | X | | | | | | |
| XY-Bewegung 220mm x 220mm | | X | X | X | X | X | X |
| XY Feinjustierung | X | | | | | | |
| XY-Mikrometer Feinjustierung | | X | X | X | X | O | O |
| Z-Bewegung Manuell 100mm | X | | | | | | |
| Z-Bewegung Automatisch 100mm | | | | | | X | X |
| Z-Bewegung Manuell 125mm | | X | X | | | | |
| Z-Bewegung Automatisch 125mm | | | | X | X | | |
| Z-Bond Kraft überwacht auf dem Bildschirm 20-1000g | X | X | X | | | | |
| Z-Bond Kraft Kontrolle 20g-10Kg (Middle Force) | | | | X | X | | |
| Z-Bond Kraft Kontrolle 20g-50Kg (High Force) | | | | | | X | X |
| Z-Aktive Bond Kraft Kontrolle 20-4000g | | | | X | X | | |
| Z-Lock während Pick & Place Zeit | | X | X | X | X | X | X |
| Z-Stop für Pick | | X | X | X | X | X | X |
| Z-Stop für Place | X | X | X | X | X | X | X |
| Z-Bond-Linie-Dicke | | | | O | O | | |
| Wafer mit Pneumatischem Die Ausstosser | | | X | | | | X |
| Wafer mit Elektronischem Die Ausstosser | | | | | X | | |
| Integrierter Dosierer | X | X | X | X | X | X | X |
| Betrieben von einem Embedded-PC (Linux). | X | X | X | | | | |
| Betrieben von einem All in One PC (Windows 10) | | | | X | X | X | X |
| Flip-Chip 1x Man. (MPA 10mmx 30mm) | O | | | | | O | O |
| Flip-Chip 1x Man. (MPA 45mmx 50mm) | | O | O | O | O | | |
| Flip-Chip 2x Man. (MPA 45mmx 50mm) | | O | O | O | O | | |
| Flip-Chip 2x Auto. (MPA 45mmx 50mm) | | | | O | O | | |
| Flip Station | | O | O | O | O | O | O |
| Tool Heizung mit externem Temperaturregler. | O | O | O | | | O | O |
| Tool Heizung mit internem Temperaturregler. | | | | O | O | | |
| Substrat Statische Heizung mit ext. Temperaturregler | O | O | O | | | O | O |
| Substrat Statische Heizung mit int. Temperaturregler | | | | O | O | | |
| Substrat Dynamische Heizung mit ext. Temperaturregler | O | O | O | | | O | O |
| Substrat Dynamische Heizung mit int. Temperaturregler | | | | O | O | | |
| Spülen mit Formiergas (kalt und manuell). | O | O | O | | | O | O |
| Spülen mit Formiergas (kalt und Software betrieben) | | | | O | O | | |
| Spülen mit Formiergas (Warm und Software betrieben) | | | | O | O | | |
| Stanzen | O | O | O | O | O | O | O |
| Stanzen mit motorisiertem Behälter. | | O | O | O | O | O | O |
| Ultraschall (manuell betrieben) | | | | | | O | O |
| Ultraschall (Software betrieben) | | O | O | O | O | | |
| UV Härtung | | | | O | O | O | O |
| Hochpräziser Dispenser (Musashi). | | | | O | O | O | O |

X Standard included O Option

Note: All specifications are subject to change without notice

Vertreten durch

Hauptsitz

www.tresky.com

Dr. TRESKY AG
 Boenrainstr. 13
 CH-8800 Thalwil
 Schweiz
 Tel.: +41 44 772 1941
tresky@tresky.com

TRESKY Corporation
 704 Ginesi Drive, Suite 11A
 Morganville, NJ 07751
 USA
 Tel.: +1 732 536 8600
sales@tresky.com

